# Analog Engineer's Circuit

# 具有 MSP430™ 智能模拟组合的低侧双向电流检测电路



## Mitch Ridgeway

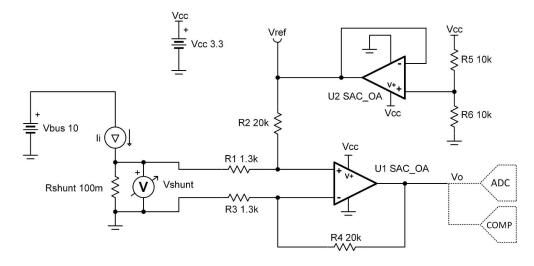
#### 设计目标

输入		输出		电源	
l <sub>iMin</sub>	I <sub>iMax</sub>	V <sub>oMin</sub>	V <sub>oMax</sub>	$V_{cc}$	V <sub>ref</sub>
-1A	1A	100mV	3.2V	3.3V	1.65V

## 设计说明

某些 MSP430™ 微控制器 (MCU) 包含可配置的集成信号链元件,例如运算放大器、DAC 和可编程增益级。这些组件组成了一个称为智能模拟组合 (SAC) 的外设。有关 SAC 的不同类型以及如何利用其可配置模拟信号链功能的信息,请访问 MSP430 MCU 智能模拟组合培训。要开始设计,请下载 低侧双向电流检测设计文件。

该单电源低侧双向电流检测解决方案可以精确地检测 - 1A 至 1A 的负载电流。输出的线性范围为 100mV 至 3.2V。低侧电流感应可以保持共模电压接近于接地值,因此特别适用于总线电压高的应用。此设计利用了 MSP430FR2355 MCU 中四个集成运算放大器模块 (SAC) 中的两个模块。其中一个 SAC\_L3 外设配置为通用运算放大器,以放大分流电阻两端的电压,而另一个配置为缓冲器,以提供偏置电压 (Vref)。后一个 SAC\_L3 块也可以配置为 DAC 缓冲模式以提供 Vref,从而取代外部分压器电路。该电路的输出可以从内部或外部连接到 MSP430FR2355 MCU 中的其他集成外设。例如,模数转换器 (ADC) 窗口比较器可以周期性地对该输出进行采样(无需 CPU 干预),并在信号超过阈值时触发中断。



#### 设计说明

- 为了最大程度地减少误差,设置  $R_3 = R_1$  且  $R_4 = R_2$ 。
- 使用精密电阻器以实现更高的精度。
- 根据线性输出摆幅设置输出范围(请参阅 Aol 规格)。
- 在系统负载无法承受小型接地干扰或需要检测负载短路的应用中,请勿使用低侧检测。
- 在上面的示意图中, MSP430FR2355 MCU (U1) 中的第一个 SAC\_L3 外设配置为通用模式。第二个 SAC\_L3 外设 (U2) 也配置为通用模式,但带有一个外部分压器。
- 为 U2 使用 DAC 缓冲器配置 (如*低侧双向电流检测设计文件* 中的代码示例所示)来提供 Vref,而不是使用外部分压器电路。
- 该方案也可以使用 MSP430FR2311 器件来实现,方法是为 U1 使用内部跨阻放大器,对 U2 使用 SAC\_L1 运算放大器。
- *低侧双向电流检测设计文件* 包含如何正确初始化 SAC 外设的代码示例。

#### 设计步骤

1. 确定传递方程,其中 R<sub>4</sub> = R<sub>2</sub>且 R<sub>1</sub> = R<sub>3</sub>。

$$V_0 = \left(I_i \times R_{shunt} \times \frac{R_4}{R_3}\right) + V_{ref}$$

$$V_{ref} = V_{cc} \times \left(\frac{R_6}{R_5 + R_6}\right)$$

2. 确定最大分流电阻。

$$R_{shunt} = \frac{V_{shunt}}{I_{imax}} = \frac{100mV}{1 A} = 100m\Omega$$

3. 设置基准电压。由于输入电流范围是对称的,因此请将基准设置为 1/2 Vs。因此,使  $R_5$  和  $R_6$  的值相等。

$$R_5 = R_6 = 10k\Omega$$

4. 根据运算放大器输出摆幅设置差分放大器增益。在电源为 3.3V 的情况下,运算放大器输出能够从 100mV 摆动至 3.2V。

$$Gain = \frac{V_{oMax} - V_{oMin}}{R_{shunt} \times (I_{iMax} - I_{iMin})} = \frac{3.2 \text{ V} - 100 \text{mV}}{100 \text{m}\Omega \times (1 \text{ A} - (-1 \text{ A}))} = 15.5 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$

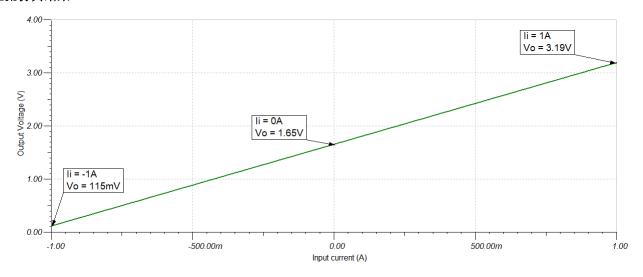
Gain = 
$$\frac{R_4}{R_3}$$
 = 15 .5  $\frac{V}{V}$ 

Choose  $R_1 = R_3 = 1.3k\Omega$  (Standard Value)

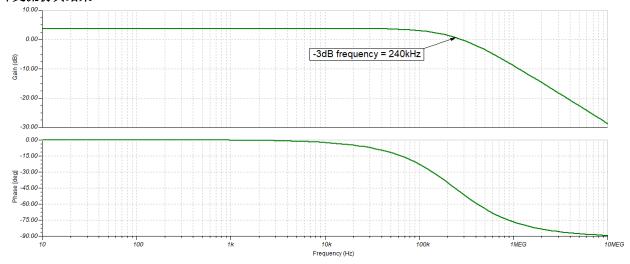
$$R_2=R_4=15.5\frac{V}{V}\times 1.3 k\Omega=20.15~k\Omega\approx 20 k\Omega$$
 (Standard Value)

# 设计仿真

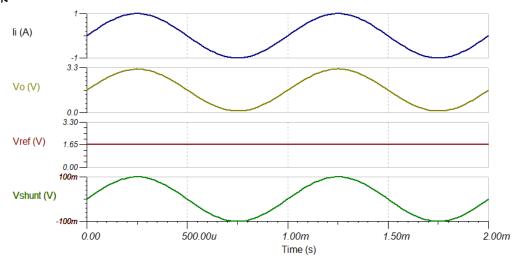
# 直流仿真结果



# 闭环交流仿真结果



## 瞬态仿真结果





## 目标应用

- 电机驱动器
- 伺服驱动器功能安全模块
- 电池充电器
- 电池组:无线电动工具
- 混合动力汽车/电动汽车电池管理系统 (BMS)

## 设计参考资料

- 1. 德州仪器 (TI), MSP430 低侧双向电流检测电路, 代码示例和 SPICE 仿真文件
- 2. 德州仪器 (TI), *具有 3.75KB FRAM、运算放大器、TIA、具有 DAC 的比较器、10 位 ADC 的 16MHz 集成模 拟微控制器*,产品页面
- 3. 德州仪器 (TI), MSP430 MCU 智能模拟组合培训, 视频

## 设计特色运算放大器

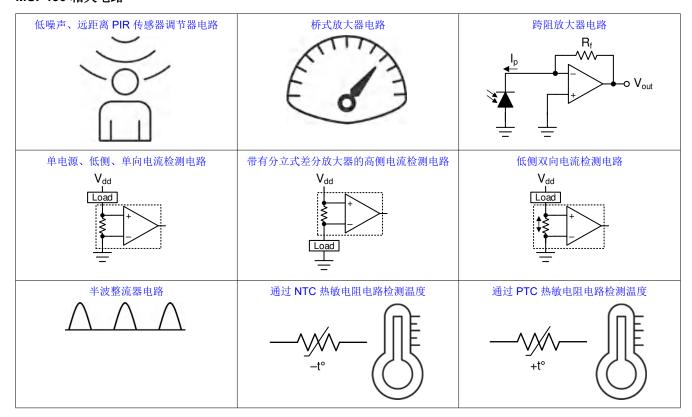
MSP430FRxx 智能模拟组合						
	MSP430FR2311 SAC_L1	MSP430FR2355 SAC_L3				
V <sub>cc</sub>	2.0V	2.0V 至 3.6V				
V <sub>CM</sub>	-0.1V 至 '	-0.1V 至 V <sub>CC</sub> + 0.1V				
V <sub>out</sub>	轨	轨到轨				
V <sub>os</sub>	±5	±5mV				
A <sub>OL</sub>	10	100dB				
	350µA ( i	350µA (高速模式)				
I <sub>q</sub>	120μA(低功耗模式)					
l <sub>b</sub>	50	50pA				
UGBW	4MHz(高速模式)	2.8MHz ( 高速模式 )				
OGBVV	1.4MHz(低功耗模式)	1MHz(低功耗模式)				
SR	3V/µs(高速模式)					
3K	1V/μs(低功耗模式)					
通道数量	1	4				
	MSP430FR2311					
	MSP430FR2355					

www.ti.com.cn 商标

## 设计备选运算放大器

MSP430FR2311 跨阻放大器				
V <sub>cc</sub>	2.0V 至 3.6V			
V <sub>CM</sub>	-0.1V 至 V <sub>CC</sub> /2V			
V <sub>out</sub>	轨到轨			
V <sub>os</sub>	±5mV			
A <sub>OL</sub>	100dB			
ı	350μA(高速模式)			
Ι <sub>q</sub>	120µA ( 低功耗模式 )			
I.	5pA(TSSOP-16,带 OA 专用引脚输入)			
l <sub>b</sub>	50pA(TSSOP-20 和 VQFN-16)			
UGBW	5MHz(高速模式)			
OGBW	1.8MHz ( 低功耗模式 )			
CD.	4V/μs ( 高速模式 )			
SR	1V/μs(低功耗模式)			
通道数量	1			
	MSP430FR2311			

## MSP430 相关电路



# 商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

# 修订历史记录

注:以前版本的页码可能与当前版本的页码不同



Changes from Revision A (March 2020) to Revision B (October 2024)	Page
• 通篇更新了表格、图和交叉参考的格式	1
Changes from Revision * (November 2019) to Revision A (March 2020)	Page
• 添加了 <i>MSP430 相关电路</i> 部分	1

# 重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2024,德州仪器 (TI) 公司